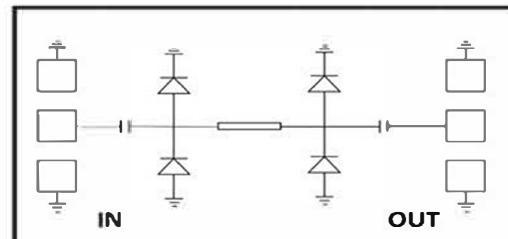


# GaAs 限幅器芯片 6-13GHz

## 主要性能

- ◎ 工作频段: 6 ~ 13 GHz
- ◎ 插入损耗: 0.42 dB
- ◎ 限幅电平: 15 dBm
- ◎ 最大输入功率: 22W (pulsed.PW=20ms.DC=40%)
- ◎ 芯片尺寸: 1.468 x 0.927 x 0.1mm
- ◎ 输入、输出端皆有隔直电容

## 功能框图



## 产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。可应用于以下范围:

- |          |           |
|----------|-----------|
| ◎ 无线通信设备 | ◎ 军事和航天   |
| ◎ 测试仪器   | ◎ 雷达和电子对抗 |

## 极限参数

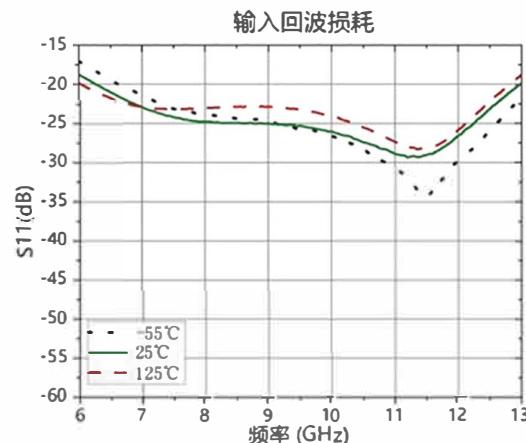
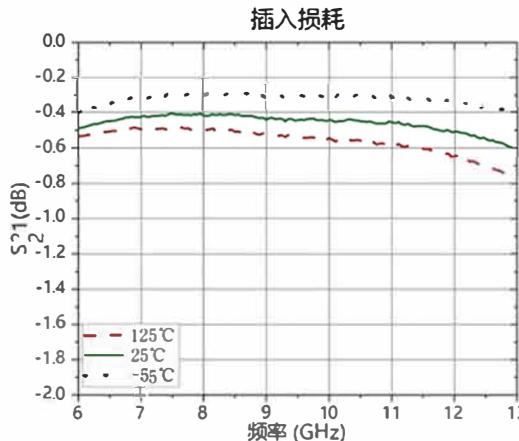
指标	数值	备注
最大输入功率	22W (pulsed.PW=20ms.DC=40%) 25°C	CW, +25°C
烧结温度	290°C	-
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	-

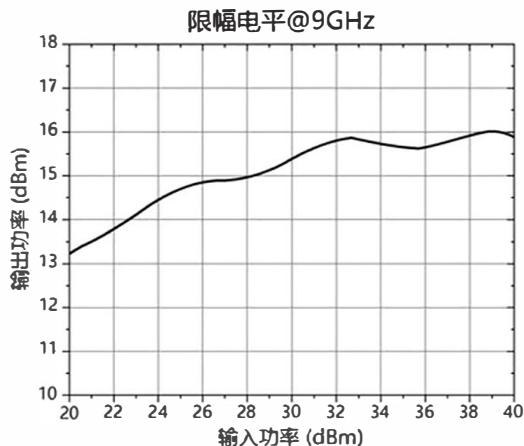
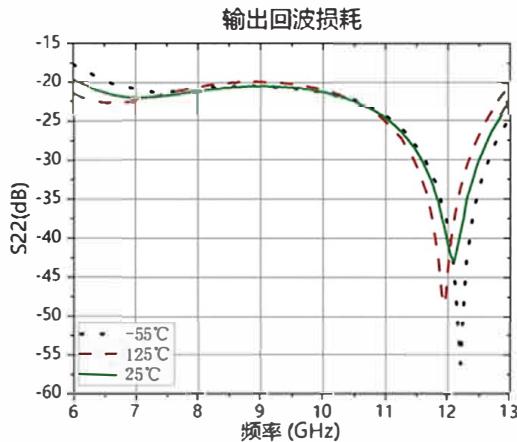
注: 超过最大值都有可能造成永久性损坏

## 电性能表 (TA=+25°C)

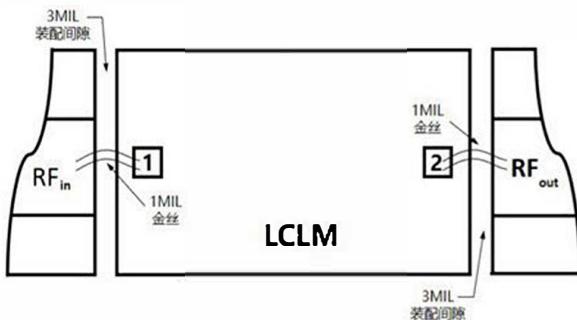
指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.42	-	dB
回波损耗	18	25	30	dB
限幅电平	-	15	-	dBm
最大输入功率	-	22	-	W

## 典型测试曲线

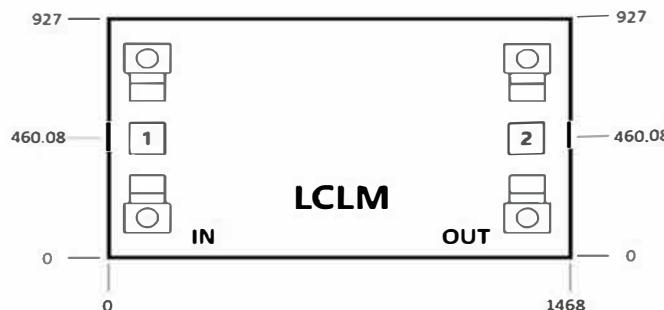




## 装配示意图



## 芯片尺寸图



## 说明:

- 单位: 微米 (um)，尺寸公差:  $\pm 50\mu\text{m}$
- 键合压点镀金，压点尺寸:  $100\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$
- 芯片背面镀金
- 芯片背面接地
- 不可在通孔上进行键合
- 压点间隙:  $150\mu\text{m}$  (GSG)

## 键合压点定义

压点 编号	功能 符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端, 阻抗 $50\Omega$
2	RFout	RF 输出端, 阻抗 $50\Omega$
-	GND	芯片背面必须接地